

第70回応用物理学会春季学術講演会 シンポジウム T28

# 低次元材料の デバイス応用の 最新動向

2023年

3月15日(水)

13:30~18:00

ハイブリッド開催  
上智大学 四谷キャンパス  
& オンライン

Recent development of device applications of low-dimensional materials

低次元材料の持つ特異な物性や機能性を生かした新規デバイスの研究開発が世界的に活発になっています。本シンポジウムでは、エネルギー分野や半導体分野における低次元材料のデバイス応用について、その最新動向を紹介いたさんとともに今後の展望を語っていただきます。

〈一般公演もお待ちしています〉

## 招待講演者

小川 新平 (三菱電機)  
グラフェンイメージセンサの開発

勝又 康弘 (JST)  
低次元材料の最新動向と応用展開への期待 (仮題)

河野 行雄 (中央大)  
シート状広帯域テラヘルツ・赤外撮像センサと  
全方位検査分析応用 (仮題)

齋藤 仁 (富士通セミコンダクター)  
高信頼性、小セル面積、高スイッチング速度を目指した  
16 Mb NRAMの開発

西原 洋知 (東北大)  
3次元化した単層グラフェンの蓄電デバイスへの応用

牧 英之 (慶応大)  
ナノカーボン材料のチップ上光デバイス応用

[敬称略/五十音順]

世話人：大野 雄高(名古屋大学), 長汐 晃輔(東京大学), 守谷 頼(東京大学)